

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会

第23回 KENMA 研究会

【難研磨材の結晶成長から粗加工～仕上げ加工まで】開催ご案内

主催：(公社)砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第23回研究会を【難研磨材の結晶成長から粗加工～仕上げ加工まで】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称：KENMA 研究会

日時：2022年7月7日(木) 13:30～16:30

開催場所：Zoom を用いてオンライン開催いたします。

内容：

【テーマ：難研磨材の結晶成長から粗加工～仕上げ加工まで】

13:30～13:35 開会挨拶

幹事 赤羽優子 (株式会社ティ・ディ・シー)

13:35～16:25 話題提供

<特別講演>

1) 13:35～14:10 ダイヤモンドウェハの研究開発動向

金沢大学 ナノマテリアル研究所 教授 (リサーチプロフェッサー)

株式会社 Kanazawa Diamond 取締役/株式会社 VISION IV 技術顧問 徳田規夫 氏

<技術講演>

2) 14:10～14:40 ダイヤモンドの作製および加工

長岡技術科学大学 會田研究室 客員准教授/株式会社 ディスコ ダイア開発部 大島龍司 氏

3) 14:40～15:10 パワー半導体用基板材料の研削加工 (仮題)

旭ダイヤモンド工業株式会社 経営戦略部 事業戦略課 係長 渡邊正和 氏

15:10～15:25 休憩

4) 15:25～15:55 固定砥粒ラップ定盤による大口径 SiC ウェハ研磨プロセスの開発

株式会社 ミズホ テクニカルラボ 製品開発部 研究開発課 野副厚訓 氏

5) 15:55～16:25 ミラー電子鏡分析を用いた SiC ウェハ加工品質向上

六甲電子株式会社 技術部 部長 池内隆啓 氏

16:25～16:30 閉会の挨拶

幹事 土田益広 (株式会社 齊藤光学製作所)

参加費：3,000円。事前振込みをお願い致します。

定員：100名 (先着順)

注意事項

- (1) 予稿集は PDF で配信いたします。
- (2) 参加申込み頂いた方には別途、事前振込みの請求書 (PDF ファイル) をメール返信でご案内をします。振込みが確認できましたら、Zoom のアドレスを配信させていただきます。
- (3) 原則、領収書の発行はございません。金融機関発行の振込明細票等をもって領収書に代えさせていただきます。
- (4) 研究会は 13:30～開始しますが、Zoom の受付は 12:30～実施します。
- (5) 参加受付をして頂いた方のみ、Zoom ログイン (受付) できるようにします。
- (6) Zoom へのログイン名は【氏名 (所属)】としてください。
- (7) 研究会から配信した Zoom アドレスを他の方に転送される、ということはお避けください。
- (8) 録音・録画はお控えください。
- (9) オンライン開催になりますのでタイムコントロールが難しく、多少の時間延長を生じる可能性がありますこと、あらかじめご理解とご了承のほどお願い申し上げます。

参加申込〆切：2022年6月21日(火)

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 精密工学 (畝田) 研究室 KENMA 研究会事務局 竹澤瑛里子

TEL：076-274-8066

E-mail：unc-assst@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第23回研究会」 参加申込書

氏名		
勤務先		
所属		
連絡先	住所	
	E-mail	